

日 本 国 特 許 庁  
JAPAN PATENT OFFICE

26.03.2004

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日  
Date of Application: 2003年 3月31日

出 願 番 号  
Application Number: 特願2003-096744  
[ST. 10/C]: [JP2003-096744]

出 願 人  
Applicant(s): 関東電化工業株式会社

REC'D 24 JUN 2004

WIPO

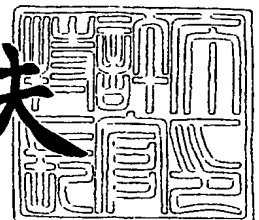
PCT

PRIORITY DOCUMENT  
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN  
COMPLIANCE WITH  
RULE 17.1(a) OR (b)

2004年 6月11日

特許庁長官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

今 井 康 夫



【書類名】 特許願

【整理番号】 030625

【提出日】 平成15年 3月31日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 G03G

【発明者】

【住所又は居所】 群馬県渋川市金井 4 2 5 番地 関東電化工業株式会社記録材料研究所内

【氏名】 飯沼 秀彦

【発明者】

【住所又は居所】 群馬県渋川市金井 4 2 5 番地 関東電化工業株式会社記録材料研究所内

【氏名】 原 研吉

【発明者】

【住所又は居所】 群馬県渋川市金井 4 2 5 番地 関東電化工業株式会社記録材料研究所内

【氏名】 林 政友

【特許出願人】

【識別番号】 000157119

【氏名又は名称】 関東電化工業株式会社

【代理人】

【識別番号】 100089705

【住所又は居所】 東京都千代田区大手町二丁目 2 番 1 号 新大手町ビル 2  
0 6 区 ユアサハラ法律特許事務所

【弁理士】

【氏名又は名称】 社本 一夫

【電話番号】 03-3270-6641

【選任した代理人】

【識別番号】 100076691

【弁理士】

【氏名又は名称】 増井 忠次

【選任した代理人】

【識別番号】 100075270

【弁理士】

【氏名又は名称】 小林 泰

【選任した代理人】

【識別番号】 100080137

【弁理士】

【氏名又は名称】 千葉 昭男

【選任した代理人】

【識別番号】 100096013

【弁理士】

【氏名又は名称】 富田 博行

【選任した代理人】

【識別番号】 100083747

【弁理士】

【氏名又は名称】 狩野 剛志

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 051806

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

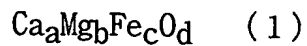
【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 Mg系フェライト並びに該フェライトを用いた電子写真現像用キャリア及び現像剤

【特許請求の範囲】

【請求項1】 式(1)



(a, b, 及びcは

$$0.20 \leq b/(b+c/2) \leq 0.85 \text{ 及び}$$

$$0 \leq R(\text{Ca}) \leq 0.10$$

(ただし  $R(\text{Ca}) = a \times \text{Fw}(\text{CaO}) / [(a \times \text{Fw}(\text{CaO}) + b \times \text{Fw}(\text{MgO}) + (c/2) \times \text{Fw}(\text{Fe}_2\text{O}_3)]$ ;  $\text{Fw}(\text{A})$ はAの式量を表す)

を充たし、dはCa、Mg、及びFeの酸化数により定まる数である)

で表され、飽和磁化が $30 \sim 60 \text{ emu/g}$ であり、絶縁破壊電圧が $1.0 \sim 5.0 \text{ kV}$ であるMg系フェライト材料。

【請求項2】 b及びcが

$$0.30 \leq b/(b+c/2) \leq 0.70 \text{ 及び}$$

を充たす請求項1のMg系フェライト材料。

【請求項3】 平均粒子径が $10 \sim 150 \mu\text{m}$ である請求項1又は2記載のMg系フェライト材料。

【請求項4】 請求項1乃至3の何れかに記載のMg系フェライト材料を含む電子写真現像用キャリア。

【請求項5】 樹脂で被覆された請求項1乃至3の何れかに記載のMg系フェライト材料を含む電子写真現像用キャリア。

【請求項6】 請求項4又は5に記載の電子写真現像用キャリアとトナーとを含む電子写真用現像剤。

【請求項7】 キャリアに対するトナーの重量比が $2 \sim 40$ 重量%である請求項6記載の電子写真用現像剤。

【請求項8】 i) 原料を混合する工程と ii) 最高到達温度が $800 \sim 1500^\circ\text{C}$ である焼成工程と iii) 最高到達温度が $300 \sim 1000^\circ\text{C}$ である酸

素含有雰囲気での熱処理工程とを含む、請求項 1 乃至 3 の何れかに記載の Mg 系フェライトの製造方法。

【請求項 9】 工程 i i) の雰囲気と工程 i i i) の雰囲気とでは後者の方が酸素濃度である請求項 8 記載の方法。

【請求項 10】 工程 i i i) の雰囲気が酸素濃度 0.05～25.0 vol. % の不活性ガス雰囲気である請求項 8 又は 9 に記載の方法。

【請求項 11】 工程 i i) の雰囲気が酸素濃度 0.001～10.0 vol. % の不活性ガス雰囲気である請求項 8 乃至 10 の何れかに記載の方法。

【請求項 12】 原料混合工程 i) が、Mg 含有化合物及び Fe 含有化合物を含むスラリーを作成する工程と該スラリーを造粒乾燥する工程とを含む、請求項 8 乃至 11 の何れかに記載の方法。

【請求項 13】 スラリーが Ca 含有化合物をさらに含む請求項 12 記載の方法。

【請求項 14】 スラリーがバインダーをさらに含み、配合した原料の総和に対するバインダーの量が 0.1～5 重量%である請求項 12 又は 13 に記載の方法。

#### 【発明の詳細な説明】

##### 【0001】

##### 【産業上の利用分野】

本発明は Mg 系フェライト磁性材料に関する。該材料は、電子写真法を利用する複写機やプリンタといった現像装置において 2 成分系現像用キャリアに使用することができ、該キャリアを用いた現像剤にも使用できる。

##### 【0002】

##### 【従来の技術】

電子写真法は、光導電性の感光体上に静電潜像を形成し、この像にトナーを付着させて現像する方法であり、2 成分現像法と 1 成分現像法に大別される。2 成分現像法では、キャリア及びトナーの 2 成分を含む現像剤を現像器内で攪拌混合し摩擦帯電させ、所望の帯電性を付与したトナーを感光体上の静電潜像に付着させる。フェライト材料のような磁性キャリアを使用する場合、磁性を有するマグ

ネットロールに帯電した現像剤を供給すると、磁力線に沿って現像剤の穂立ちが生じる（磁気ブラシ）。このようにして形成された磁気ブラシを感光体表面と接触させることにより、トナーを感光体に移すことができる。一方、キャリアはロール上に残存して回収されて再利用されるため、高寿命であることが望ましい。

#### 【0003】

電子写真法は複写機、プリンタ、FAXなど幅広い分野で用いられているが、さらなる高画質化、高解像度化、並びに階調性及び細線再現性の改善等が求められている。現像工程ではキャリアを介した静電潜像電位のリークが起きることがあるが、このリーク現象は画質を低下させるため好ましくない。また、高画質化のため感光体及び現像ロール間に高いバイアス電位が印加されるが、キャリアの絶縁破壊によるリーク現象に加えキャリアの寿命低下も生じることがある。従って、リーク現象が起こりにくく絶縁破壊電圧の高い電子写真現像用キャリアが求められている。

#### 【0004】

高画質化のためには、磁性キャリアの飽和磁化も適切な範囲に調整する必要がある。飽和磁化が小さすぎると、キャリアの飛散やキャリア付着により画質が低下し、飽和磁化が大きすぎても、穂が硬くなって画質の低下を招くためである。

#### 【0005】

従来、絶縁破壊電圧の高いフェライトキャリアとして Cu-Zn系フェライト（例えば特許文献1参照）、Mn-Mg系フェライト（例えば特許文献2参照）が用いられてきた。しかし近年の環境規制により、Cu、Zn、Mn、Co及びNiといった重金属の使用量の削減が望まれている。例えば米国カリフォルニア州法Title 22等ではNi, Cu, Zn等が規制対象とされ、またMn化合物は人の健康や生態系に有害のおそれのある化合物としてPRTR制度で指定されている。

#### 【0006】

環境面に対応した磁性キャリアとして、従来から用いられているマグネタイト（ $\text{Fe}_3\text{O}_4$ ）があるが、マグネタイトには絶縁破壊電圧が低いという問題がある。さらに低抵抗という問題もあり、交流電圧を印加した場合には、各種樹脂で被覆し絶縁性を改善しても現像時にリーク現象が生じてしまう。マグネタイトを高抵

抗化するため、大気中で焼成して高抵抗の非磁性相 ( $\text{Fe}_2\text{O}_3$ 相) を生成するという試みも為されている。確かに  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  相の割合を増加させると絶縁破壊電圧は高くなるが、その一方で保磁力が増加するため、キャリア粒子間での凝集が生じて流動性が悪化し、フェライトキャリア並の画質が得られにくいという新たな問題が生じる。それに加え、マグネタイトは比較的飽和磁化が大きいいため、磁気ブラシの穂が硬くなりすぎるという問題もある。

#### 【0007】

任意の飽和磁化に調整でき環境規制にも対応できる酸化物キャリアとしては、Mg-Fe-O系の粉体が報告されている(特許文献3参照)。しかし、この方法ではバインダーを還元剤として添加し不活性ガス中で焼成が行われるため、Feの原子価が低く保たれる結果、マグネタイト及びMgO相等の混在した粉体が生成する。従って、マグネタイトに起因する低い絶縁破壊電圧という問題が依然として残されている。

#### 【0008】

Mg系フェライトは、化学量論組成において大気中で焼成すると高い絶縁破壊電圧を実現することができる。しかし、飽和磁化が20~25 emu/gという低い値であるという問題がある。従って、適切な飽和磁化と高い絶縁破壊電圧の両者を同時に実現するという課題が残されている。

#### 【0009】

【特許文献1】 特許第1, 688, 677号公報

【特許文献2】 特許第3, 243, 376号公報

【特許文献3】 特許第2, 860, 356号公報

#### 【0010】

【発明が解決しようとする課題】

本発明は上記のような事情に鑑みなされたものであり、環境規制に対応し高品質の画像が得られる磁性キャリア、特にMg系フェライト材料を含むキャリア、該Mg系フェライト材料の製造方法、及び該キャリアを含む電子写真現像剤を提供することを目的とする。

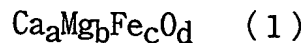
#### 【0011】

## 【課題を解決するための手段】

本発明者らはこれらの課題を解決すべく鋭意検討を進めた結果、Mg系フェライト材料及びCa含有Mg系フェライト材料（以下、「Mg系フェライト」とはCaを含有する場合も含む）が、電子写真現像用キャリアに要求される性能（例えば飽和磁化や絶縁破壊電圧）を有することを見出し、本発明を完成させた。また、該フェライト材料の特性が少なくとも2段階の焼成工程により実現できること、特に前段の工程を不活性ガス雰囲気下で行い後段の工程を酸素含有雰囲気下で行うことによって実現できることも見出した。

## 【0012】

即ち上記課題は、式（1）



(a, b, 及びcは

$$0.20 \leq b/(b+c/2) \leq 0.85 \text{ 及び}$$

$$0 \leq R(\text{Ca}) \leq 0.10$$

（ただし  $R(\text{Ca}) = a \times \text{Fw}(\text{CaO}) / [(a \times \text{Fw}(\text{CaO}) + b \times \text{Fw}(\text{MgO}) + (c/2) \times \text{Fw}(\text{Fe}_2\text{O}_3)]$  ;  $\text{Fw}(\text{A})$  はAの式量を表す）

を充たし、dはCa、Mg、及びFeの酸化数により定まる数である）

で表され、飽和磁化が  $30 \sim 60 \text{ emu/g}$  であり、絶縁破壊電圧が  $1.0 \sim 5.0 \text{ kV}$  であるMg系フェライト材料によって解決する。b及びcは

$$0.30 \leq b/(b+c/2) \leq 0.70 \text{ 及び}$$

を充足してもよい。平均粒径は  $10 \sim 150 \mu\text{m}$  にすることができる。

## 【0013】

上記課題は、該Mg系フェライト材料を含む電子写真現像用キャリアによっても解決する。該材料を樹脂で被覆してもよい。さらに、このキャリアとトナーとを含む電子写真用現像剤によっても解決する。キャリアに対するトナーの重量比を  $2 \sim 40 \text{ 重量\%}$  とすることができる。

## 【0014】

該Mg系フェライト材料は、i) 原料を混合する工程と ii) 最高到達温度が  $800 \sim 1500^\circ\text{C}$  である焼成工程と iii) 最高到達温度が  $300 \sim 1000$



℃である酸素含有雰囲気での熱処理工程とを含む製造方法により製造できる。工程 i i) の雰囲気と工程 i i i) の雰囲気とでは後者の方が酸素濃度を高くすることができる。さらに、工程 i i i) を酸素濃度 0.05 ~ 25.0 vol. % の不活性ガス雰囲気下で行い、工程 i i) を酸素濃度 0.001 ~ 10.0 vol. % の不活性ガス雰囲気下で行うことができる。また、Mg 含有化合物及び Fe 含有化合物を含むスラリーを作成し、該スラリーを造粒乾燥することにより原料混合工程 i) を行うことができる。スラリーが Ca 含有化合物及び／又はバインダーを含んでもよく、配合した原料の総和に対するバインダーの量を 0.1 ~ 5 重量%にできる。

#### 【0015】

##### 【発明の実施の態様】

本発明のMg系フェライト材料は磁性材料として各種の用途、例えば磁性流体、磁気記録等に使用することができ、特に電子写真現像で使用することができる。

#### 【0016】

本発明のMg系フェライト材料は、飽和磁化が25 emu/g以上、好ましくは30 emu/g以上、さらに好ましくは40emu/g以上であり、80 emu/g以下、好ましくは70 emu/g以下、さらに好ましくは60 emu/g以下である。飽和磁化が小さすぎるとキャリア付着がおき、画質が低下する。飽和磁化が大きすぎても、穂が硬くなって画質の低下を招く。

#### 【0017】

なお、ここで使用する飽和磁化の値は振動型磁力計を用いて14kOeで測定される値であり、測定方法は実施例記載の通りである。

絶縁破壊電圧に関しては、1.0 kV以上、好ましくは2.5 kV以上である。絶縁破壊電圧が低すぎると、現像の際に感光体上の静電潜像電位のリークが生じ、キャリアの寿命低下も起きることがある。絶縁破壊電圧が高ければ安定に作動させることができるため、その上限に制限はないが、他の特性を充足するために10.0 kV以下、好ましくは7.5 kV以下、さらに好ましくは5.0 kV以下とすることができる。

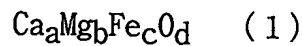
#### 【0018】

なお、ここで使用する絶縁破壊電圧の値は交流電圧を印加して漏れ電流値が110 mA以上となる値であり、測定方法は実施例記載の通りである。

該Mg系フェライト材料の平均粒径は、 $2\mu\text{m}$ 以上、好ましくは $5\mu\text{m}$ 以上、さらに好ましくは $10\mu\text{m}$ 以上であり、 $200\mu\text{m}$ 以下、好ましくは $150\mu\text{m}$ 以下である。粒径が小さすぎると感光体に付着しやすくなり、大きすぎると画像が粗くなり画質が低下する。

#### 【0019】

本発明のMg系フェライト材料は、式(1)



(a, b, 及びcは

$$0.20 \leq b/(b+c/2) \leq 0.85 \text{ 及び}$$

$$0 \leq R(\text{Ca}) \leq 0.10$$

(ただし  $R(\text{Ca}) = a \times \text{Fw}(\text{CaO}) / [(a \times \text{Fw}(\text{CaO}) + b \times \text{Fw}(\text{MgO}) + (c/2) \times \text{Fw}(\text{Fe}_2\text{O}_3)]$ ;  $\text{Fw}(\text{A})$  はAの式量を表す)

を充たし、dはCa、Mg、及びFeの酸化数により定まる数である)

で表され、b及びcは

$$0.30 \leq b/(b+c/2) \leq 0.70$$

を充足してもよい。

#### 【0020】

Caを添加すると、高い絶縁破壊電圧を維持しつつ飽和磁化を向上させる効果が得られる。その結果、階調性に優れた高品質の画像を得ることができる。このような効果が得られる理由は明らかではないが、Mgサイトを置換することにより結晶の構造安定性や導電性に影響を及ぼしたり、超交換相互作用を介して磁気構造を変化させたり、固溶せずに粒界を修飾したり、磁区構造が変化することに起因するとも考えられる。

#### 【0021】

該Mg系フェライト材料は、さらにLi、Na、K、Rb、Ba、Sr、B、Al、Si、V、Ti、Zr、Cu、Ni、Co、Zn、Mn、La、Yからなる一種以上の元素を含んでもよい。これらの元素はCa、Mg、及びFeのサイトを置換してもよく、別の相を形成してもよ

い。ただし、環境規制の対応という観点からは、含有される重金属のモル数の和がMgとCaのモル数の和を超えないことが好ましい。

#### 【0022】

ここでフェライト材料とは正スピネル相又は逆スピネル相のフェライトを含む材料を指すが、Feを含有するその他の相、例えばガーネット相やマグネトプランバイト相を含んでもよく、Feを含有しない相、例えばMgOやCa<sub>2</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>5</sub>を含んでもよい。

#### 【0023】

a、b、及びcの値は所望の特性が得られれば特に制限はないが、例えば $b/(b+c/2)$ を0.20以上0.85以下とすることができる。 $b/(b+c/2)$ が小さすぎると、過剰のFe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>の生成によって絶縁破壊電圧が低下する傾向にあり、 $b/(b+c/2)$ が大きすぎると非磁性相（例えばMgO相）が過剰に生成し、飽和磁化が低下しやすい。Ca添加すると高い絶縁破壊電圧を維持しつつ飽和磁化を増加させることができるため、Ca無添加の場合には十分な飽和磁化が得られないMgリッチな組成（ $b/(b+c/2)$ が大きい組成）であっても、Caの添加により適切な飽和磁化と高い絶縁破壊電圧とを両立させることができる。Caを添加しない場合には、 $b/(b+c/2)$ を0.30以上0.70以下とすることが好ましい。

#### 【0024】

Caを添加する場合、その添加量の下限に特に制限はないが、 $R(Ca)$ が0.001以上であればその効果を確認できる。Caを過剰に添加すると不純物相（例えばCa<sub>2</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>5</sub>）が生成して飽和磁化が低下するため、 $R(Ca)$ は0.10以下、好ましくは0.08以下とされる。

#### 【0025】

以下、本発明のMg系フェライトキャリアの製造方法について述べる。本発明のMg系フェライト材料は、i) 原料を混合する工程と ii) 最高到達温度が800～1500℃である焼成工程と iii) 最高到達温度が300～1000℃である酸素含有雰囲気での熱処理工程とを含む製造方法により製造できる。

#### 【0026】

混合工程 i) に用いる原料としては、酸化物、炭酸塩、水酸化物、オキシ水酸

化物、シュウ酸塩、硝酸塩、酢酸塩、乳酸塩、塩化物といった各種の化合物を使用することができる。例えばMg原料としてはMgO、MgCO<sub>3</sub>、Mg(OH)<sub>2</sub>、及びMgCl<sub>2</sub>などを使用することができ、Fe原料としてはFeO、Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>、及びFe(OH)<sub>x</sub> (xは2以上3以下の数を表す) などが使用でき、Ca原料としてはCaO、CaCO<sub>3</sub>、Ca(OH)<sub>2</sub>、及びCaCl<sub>2</sub>などが使用可能である。焼成過程での発生ガス処理を考慮すると、酸化物、炭酸塩、水酸化物、シュウ酸塩、及びオキシ水酸化物を使用することができる。各々の元素について一つの化合物を使用してもよく、複数の化合物の混合物を原料としてもよい。また、共沈法などにより予め所定比で混合した原料を用いてもよい。

#### 【0027】

上記の原料を秤量し、所定の組成になるように配合する。配合方法に特に制限はなく、各種の湿式混合及び乾式混合を用いることができるが、水による湿式混合を行うこともできる。例えば、湿式ボールミル、アトライター、ダイノミルなどで粉碎混合し、スラリー化される。スラリーには、バインダーを所定量加えてもよい。バインダーとしては各種の高分子、例えばポリビニルアルコール、CMC、アクリル系増粘剤を用いることができる。ポリビニルアルコールを使用する場合には、上記の様に配合した原料の総和に対して0.1~5重量%であることが好ましい。必要に応じて分散剤、消泡剤等を適量添加することができる。焼結助剤（例えば、B、Al、Si、Sr、V、Y、Bi、La、Ti、Zr等の酸化物または塩化物）をスラリーに添加してもよく、焼成前に固相混合してもよく、焼成または熱処理中に気相で供給してもよい。焼結助剤は後述する熱処理後に残存してもよい。

#### 【0028】

このようにして得られたスラリーを、スプレードライヤにて造粒乾燥し、球状ペレットにする。球状ペレットの形状は所望のフェライト材料の形状に応じて調整されるが、例えば10~200 $\mu$ m程度の平均粒径にできる。

#### 【0029】

混合した原料について、ii) 焼成工程とiii) 熱処理工程を行う。本発明の製造方法には、不活性ガス雰囲気下で焼成して粒子を成長させる工程ii) と、酸素含有雰囲気下で熱処理を行って金属の酸化数、結晶構造、占有率、磁気構

造等を制御する工程 i i i) の少なくとも 2 つの加熱工程が含まれる。そして焼成及び熱処理工程の条件、例えば酸素濃度、焼成温度、焼成時間、熱処理温度及び熱処理時間を調整することにより、絶縁破壊電圧や飽和磁化といった磁性キャリアに求められる特性を制御することが可能である。例えば、工程 i i i) を工程 i i) より高い酸素濃度雰囲気で行い、工程 i i) の最高到達温度を工程 i i i) より高くすることができる。なお、上記の工程 i i) の前に仮焼を行ってもよい。工程 i i) と工程 i i i) とは別々の工程としてもよく、連続して行ってもよい。

#### 【0030】

工程 i i) は、酸素濃度が 10 vol. % 以下の不活性ガス（例えば、窒素、アルゴン等の希ガス、及びそれらの混合物） 雰囲気中で行うことができる。酸素濃度の下限に特に制限はなく、実質的に酸素を含まない状態でも可能であるが、好ましくは 0.001 vol. % 以上であれば良い。ここで実質的に酸素を含まない状態とは、酸素濃度が 0.001 vol. % 未満であることをいうものとする。また、還元ガスを更に添加してもよい。

#### 【0031】

その後行われる熱処理工程 i i i) は酸素含有雰囲気中で行われる。酸素の濃度は 0.05 ~ 70 vol. %、好ましくは 0.05 ~ 50 vol. %、さらに好ましくは 0.05 ~ 25 vol. % である。酸素以外の気相成分は不活性ガスとすることがよい。

#### 【0032】

工程 i i) の最高到達温度は所望の粒子成長が起きるように選択できる。この温度は原料の粉碎及び混合の程度にも依存するが、平均粒径 10 ~ 150  $\mu\text{m}$  とするには 800 ~ 1500  $^{\circ}\text{C}$  とすることが好ましい。その後の熱処理工程 i i i) の温度は所望の物性が得られるよう選択され、例えば 200 ~ 1500  $^{\circ}\text{C}$ 、好ましくは 300 ~ 1000  $^{\circ}\text{C}$  とされる。工程 i i) で、バインダー量が多くなるとバインダーの還元剤としての作用が無視できなくなるため、バインダーの種類の選定とその添加量のバランスをとることが必要である。

#### 【0033】

得られた Mg 系フェライトを解砕機で解砕し、解砕粉を分級または篩分けして各

種用途のフェライト材料として所望の粒径及び粒度分布とし、使用に供する。近年、電子写真用キャリアとして使用するためには平均粒径を $10\sim 150\mu\text{m}$ とすることが求められており、この範囲に調整することもできる。

#### 【0034】

このようにして得られた本発明のMg系フェライト材料について、適宜表面処理を行うことができる。例えば、Mg系フェライト材料をコア材とし、その表面を樹脂で被覆することもできる。使用される被覆樹脂としては、被覆フェライト材料が所望の物性を充たせば特に制限はなく、例えばシリコン系樹脂（シリコン樹脂およびその誘導体）、フッ素系樹脂、スチレン系樹脂、アクリル系樹脂、メタアクリル系樹脂、ポリエステル系樹脂、ポリアミド系樹脂、エポキシ系樹脂、ポリエーテル系樹脂、フェノール系樹脂、メラミン系樹脂等が挙げられる。これらの樹脂は、単独で或いは複合的（混合コーティングまたは重層コーティング）に使用することができ、共重合体を使用することも可能である。また、必要に応じて樹脂中に他の成分、例えば帯電制御剤、抵抗制御剤、密着性向上剤等を添加してもよく、その使用に特に制限はない。

#### 【0035】

上記の樹脂の被覆方法についても特に制限はなく、従来公知の方法は何れも使用することができ、適宜選択すればよい。例えば、流動床によるスプレー法や浸漬法が挙げられる。通常は、上記の樹脂をメチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、テトラヒドロフラン、トルエン、キシレン、クロロホルム、アルコール等の有機溶剤又はこれらの混合溶剤に希釈または分散させて樹脂溶液を調製し、又はエマルジョンにして使用する。そして当該樹脂溶液又はエマルジョンに本発明のフェライトコア材を浸漬させるか、または予めこのフェライトコア材を流動化させた状態で上記樹脂溶液をスプレーすることにより、樹脂層を形成する。流動状態でスプレーすることにより、均一な被膜を得ることができる。

#### 【0036】

被覆樹脂の量は、フェライト材料の0.05～10.0重量%が好ましい。樹脂量が0.05重量%未満ではフェライト粒子表面が十分に被覆されないことがあり、10.0重量%以上ではフェライト粒子間で造粒が生じてしまうことがある。

## 【0037】

被膜形成後に溶剤除去及び樹脂の焼き付けを行うため、各種の加熱方法を用いることができる。加熱温度は使用した溶剤及び樹脂に依存するが、該樹脂の融点又はガラス転移点以上の温度にすることが望ましい。加熱処理した粒子を冷却した後、必要に応じて再度解砕及び分級が行われる。

## 【0038】

被覆工程を焼成工程 i i) と熱処理工程 i i i) の間に行い、樹脂の焼き付けと熱処理を同時に行うこともできる。

本発明のMg系フェライトキャリアは、トナーと所定の比率で混合して2成分現像剤として用いられる。2成分系現像剤の場合、トナー濃度はキャリアに対し2～40重量%であることが好ましい。トナーとしては各種公知のトナーを使用することができ、その製造方法も特に制限されるものではなく、粉碎トナーであっても重合トナーでもよい。

## 【0039】

トナーは結着樹脂中に着色剤、帯電制御剤等を分散させたものである。結着樹脂として特に制限はなく、ポリスチレン樹脂、スチレン-アクリル系樹脂、スチレン-クロロスチレン系樹脂、ポリエステル系樹脂、エポキシ樹脂、ポリウレタン樹脂等が挙げられる。着色剤及び荷電制御剤としては、従来公知の剤を適宜選択することができる。

## 【0040】

また、本発明のMg系フェライトはトナー中の材料としても使用することもできる。例えば、磁性トナーの磁性材料として使用することができる。

## 【0041】

## 【実施例】

以下、実施例により本発明を説明するが、本発明はこれらの実施例に限定されるものではない。

## [実施例 1～12]

## [Mg系フェライトの製造]

MgO、Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、及びCaOを原料とし、表1に示す組成となるよう秤量し、バインダ

ー (ポリビニルアルコール)、分散剤、及び消泡剤とともに水に加え、湿式ボールミルで4時間粉碎混合した。なお、スラリー濃度は50重量%とした。得られたスラリーをスプレードライヤにて造粒乾燥し、球状ペレットとした。この球状ペレットを電気炉にて窒素雰囲気中において1200℃で焼成した。窒素雰囲気中の酸素濃度は1000ppm以下となるようにした。次にこの焼成物を酸素濃度20 vol. %の窒素雰囲気中において500℃で熱処理した。その後、解砕、分級して平均粒径50 $\mu$ mのMg系フェライトを得た。なお、表1では、Mg及びFeの量をMgO:Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>のモル比で表記し、Caの量を(MgO+Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)の重量の和に対するCaOの重量%で表記した。表2についても同様である。

## 【0042】

得られたMg系フェライトの飽和磁化、絶縁破壊電圧、及び電気抵抗を表1に、飽和磁化と絶縁破壊電圧の関係を図1に示す。

## 【0043】

【表1】

試料	組成			焼成条件 ℃	熱処理 20% O <sub>2</sub> ℃	飽和 磁化 emu/g	絶縁破 壊電圧 kV	電気抵抗 $\Omega$	画像評価	備考
	MgO モル比%	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> モル比%	CaO 重量%							
実施例1	70	30	—	1200, N <sub>2</sub>	500	30.3	4.2	$7.2 \times 10^8$	良好	
実施例2	60	40	—	"	"	32.0	4.2	$8.5 \times 10^8$	"	
実施例3	50	50	—	"	"	31.8	4.4	$3.5 \times 10^9$	"	
実施例4	40	60	—	"	"	35.9	4.3	$3.3 \times 10^9$	"	
実施例5	35	65	—	"	"	39.8	4.5	$1.2 \times 10^9$	"	
実施例6	30	70	—	"	"	36.2	4.3	$8.5 \times 10^8$	"	
実施例7	50	50	2	"	"	41.0	4.3	$3.5 \times 10^9$	"	
実施例8	50	50	4	"	"	37.9	4.2	$2.6 \times 10^9$	"	
実施例9	50	50	8	"	"	33.0	4.4	$4.3 \times 10^9$	"	
実施例10	35	65	2	"	"	47.3	4.2	$1.8 \times 10^9$	"	
実施例11	35	65	4	"	"	51.5	4.2	$1.1 \times 10^9$	"	
実施例12	35	65	8	"	"	41.5	4.1	$1.5 \times 10^9$	"	
比較例1	75	25	—	"	"	24.5	4.2	$7.0 \times 10^8$	キタ付着	組成外れ
比較例2	25	75	—	"	"	45.0	0.9	$3.8 \times 10^{10}$	現像リナ	"
比較例3	50	50	15	"	"	25.1	3.6	$1.0 \times 10^{10}$	キタ付着	"
比較例4	35	65	15	"	"	27.5	3.3	$3.4 \times 10^{10}$	"	"
比較例5	50	50	—	"	—	44.9	0.4	$5.8 \times 10^6$	現像リナ	熱処理無し
比較例6	35	65	—	"	—	51.2	0.4	$2.8 \times 10^7$	"	"
比較例8	50	50	—	1200, Air	—	21.7	4.2	$2.8 \times 10^{10}$	キタ付着	Air 焼成
比較例9	35	65	—	"	—	17.9	4.8	$4.5 \times 10^7$	"	"

## 【0044】

実施例3及び7～9より、並びに実施例5及び10～12よりわかるように、



適切な量のCaを添加すると、高い絶縁破壊電圧を維持しつつ飽和磁化を向上させることができる。

#### 【0045】

なお、飽和磁化、絶縁破壊電圧、及び電気抵抗の測定条件は以下の通りである。

##### <飽和磁化の測定>

飽和磁化測定には振動型磁力計 (VSMP-1S, 東英工業製) を用い、試料を測定用カプセル (0.0565cc) に充填して磁場14kOeで測定した。

##### <絶縁破壊電圧の測定>

絶縁破壊電圧測定は、N極およびS極を対向させ磁極間間隔8mmとした測定器でおこなった (磁極: 表面磁束密度1500G、対向磁極面積10×30mm)。測定器の概要を図2に示す。この磁極間に非磁性の平行平板電極 (電極面積10×40mm、電極間隔4mm) を配置し、該電極間に試料を200mg入れ、磁力により電極間に試料を保持した。耐電圧試験器 (TOS5051、菊水電子工業製) を用いて交流電圧を印加し、漏れ電流値が110mA以上となる印加電圧値を絶縁破壊電圧とした。

##### <電気抵抗>

電気抵抗測定には上記の絶縁破壊電圧測定と同様の電極に試料を保持し、絶縁抵抗測定器 (TR-8601、武田理研製) を用いて直流電圧100Vを印加して測定した。

#### [コーティングキャリアの製造]

得られたMg系フェライトをコア材としてシリコン樹脂で被覆し、コーティングキャリアを製造した。被覆処理は、Mg系フェライトにトルエンで希釈したシリコン樹脂溶液をスプレーコーティングし、続いて250℃で熱処理することにより行った。なお、被覆樹脂量はコア材の0.5重量%とした。該コーティングキャリアを、トナー濃度4重量%となるよう市販の2成分系現像剤用トナーと混合し、得られた現像剤を用いて市販の複写機で画像評価を行った (表1)。評価項目は、キャリア付着及び現像リークの確認とした。

[比較例1～4] MgO、Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、及びCaOを表1記載の組成となるよう秤量分取し、実施例1～12と同様の方法によりMg系フェライトを製造した。飽和磁化、

絶縁破壊電圧、及び電気抵抗の値を表1に示し、飽和磁化と絶縁破壊電圧の関係を図1に示す。

#### 【0046】

このMg系フェライトを実施例1～12と同様な方法でコーティングし、画像評価を行った(表1)。

[比較例5～7] 比較例5～7では、酸素濃度20vol. %の窒素雰囲気中における熱処理を行わなかった点を除き、実施例1～12と同様の方法によりMg系フェライトを製造した。なお、MgO、Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、及びCaOは表1及び2中の組成となるよう秤量分取した。

#### 【0047】

飽和磁化、絶縁破壊電圧、及び電気抵抗の測定結果を表1及び2に示し、飽和磁化と絶縁破壊電圧の関係を図1に示す。焼成後の粒子の平均粒径50 $\mu$ mであった。この試料を実施例1～12と同様な方法でコーティングし、画像評価を行った(表1及び2)。

#### 【0048】

【表2】

試料	組成			焼成条件 ℃	熱処理 20% O <sub>2</sub> ℃	飽和 磁化 emu/g	絶縁破 壊電圧 kV	電気抵抗 $\Omega$	画像評価	備考
	MgO	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	CaO							
	モル比%	モル比%	重量%							
比較例7	35	65	4	1200, N <sub>2</sub>	—	56.0	0.3	$1.2 \times 10^7$	現像リク	熱処理無し
実施例13	"	"	"	"	400	55.0	1.3	$2.9 \times 10^8$	良好	
実施例14	"	"	"	"	450	52.4	3.5	$3.8 \times 10^9$	"	
実施例11	"	"	"	"	500	51.5	4.2	$1.1 \times 10^9$	"	
実施例15	"	"	"	"	800	33.3	5.0	$6.2 \times 10^9$	"	

#### 【0049】

[比較例8及び9] 比較例8及び9では、窒素雰囲気中での1200℃焼成及び酸素濃度20vol. %の窒素雰囲気中での500℃熱処理を行わず、それに代えて電気炉において大気中1200℃での焼成を行った。その他の点では実施例1～12と同様の方法により、Mg系フェライトを製造した。なお、MgO及びFe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>は、表1の組成となるよう秤量分取した。

#### 【0050】

飽和磁化、絶縁破壊電圧、及び電気抵抗の測定結果を表1に示し、飽和磁化と絶縁破壊電圧の関係を図1に示す。なお、焼成後に得られた粒子の平均粒径は50  $\mu\text{m}$ であった。この試料を実施例1～12と同様な方法でコーティングし、画像評価を行った(表1)。

【実施例13～15】 実施例13～15では、酸素濃度20 vol. %の窒素雰囲気中での熱処理温度を表2に記載の温度に変更した。その他の点では実施例1～12と同様な方法により、Mg系フェライトを製造した。なお、MgO、Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>及びCaOは、表1の組成となるよう秤量分取した。

#### 【0051】

飽和磁化、絶縁破壊電圧、及び電気抵抗の測定結果を表2に示し、飽和磁化と絶縁破壊電圧の関係を図1に示す。なお、焼成後に得られた粒子の平均粒径は50  $\mu\text{m}$ であった。この試料を実施例1～12と同様な方法でコーティングし、画像評価を行った(表2)。

#### 【0052】

以上の結果から明らかなように、本発明のMg系フェライトキャリアは現像リークやキャリア付着を起こさず、良好な画像が得られるという利点を有する。このような利点は、適切な飽和磁化及び高い絶縁破壊電圧の両者を実現したことに起因すると推測される。従来も高い絶縁破壊電圧を示すMg系フェライトは存在したが、飽和磁化が低いという問題があった。本発明のMg系フェライトは、高い絶縁破壊電圧を維持しつつ飽和磁化が改善されたという特徴を有する。

#### 【0053】

##### 【発明の効果】

本発明のMg系フェライト材料及びCa添加Mg系フェライト材料では、従来のMg-Fe-O系フェライトの課題であった低い絶縁破壊電圧が改善されており、さらに適切な飽和磁化の値を示す。本発明の電子写真現像用Mg系フェライトキャリアにより、近年の環境規制に対応できるだけでなく高画質化を図ることができ、現像剤の幅広い設計を可能にする。

##### 【図面の簡単な説明】

【図1】 図1は、本発明のMg系フェライトキャリアの飽和磁化と絶縁破壊電圧

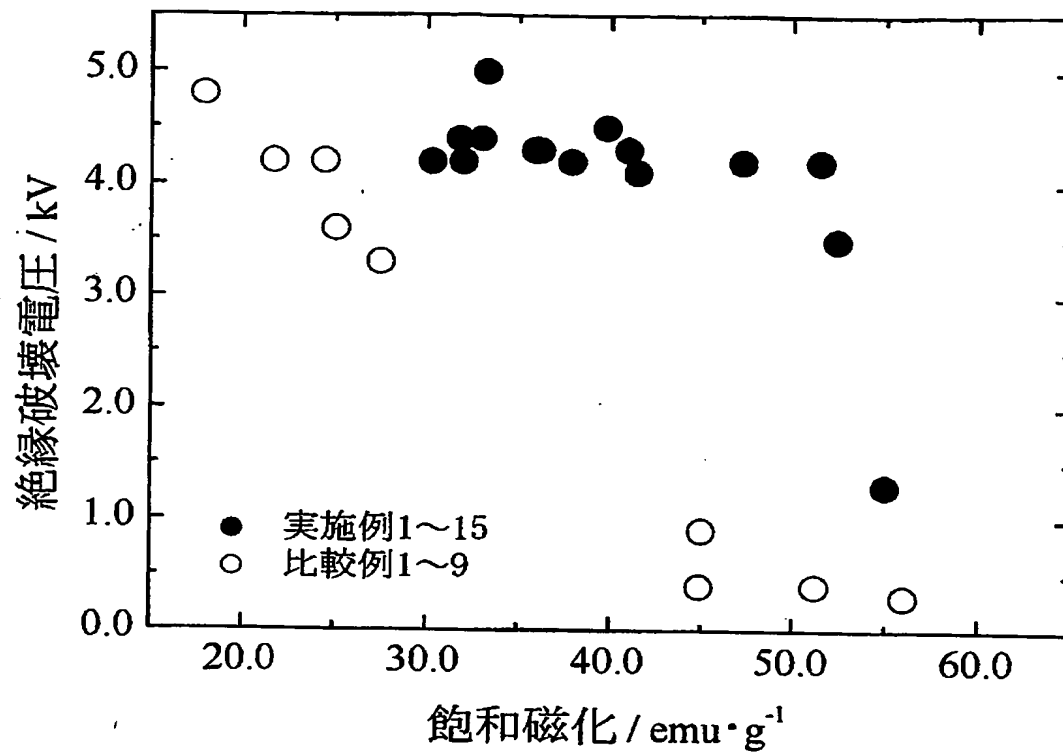
との関係を示す。

【図2】 図 2 は、絶縁破壊電圧測定器の回路図面である。

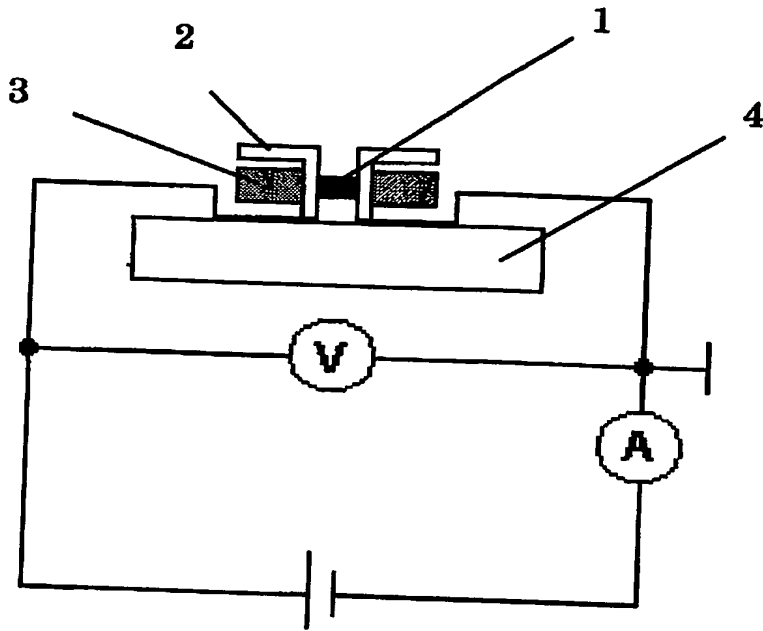
[符号説明] 1:試料、2:真鍮、3磁極、4:テフロン (R) 支持台

【書類名】 図面

【図1】



【図 2】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 環境規制に対応したクリーンな材料で構成され、鮮明で階調性に富みカブリのない高画質像が得られるMg系フェライトキャリア、及び該キャリアを含む電子写真現像剤を提供する。

【解決手段】 飽和磁化が30～60emu/gであり、絶縁破壊電圧が1.0～5.0 kVである式(1)のMg系フェライト材料によって、高画質化と環境規制への対応を図ることができる。上記の特性は、所定の焼成及び熱処理条件により達成される。

$\text{Ca}_a\text{Mg}_b\text{Fe}_c\text{O}_d$  (1)  $(a, b, cが0.20 \leq b/(b+c/2) \leq 0.85$ 及び $0 \leq R(\text{Ca}) \leq 0.10$  (ただし  $R(\text{Ca}) = a \times \text{Fw}(\text{CaO}) / [(a \times \text{Fw}(\text{CaO}) + b \times \text{Fw}(\text{MgO}) + (c/2) \times \text{Fw}(\text{Fe}_2\text{O}_3)]$ ;  $\text{Fw}(\text{A})$ はAの式量を表す) を充たし、dはCa、Mg、及びFeの酸化数により定まる数である。)

特願 2003-096744

ページ: 1/E

出願人履歴情報

識別番号

[000157119]

1. 変更年月日  
[変更理由]  
住所  
氏名

1990年 8月16日  
新規登録  
東京都千代田区丸の内1丁目2番1号  
関東電化工業株式会社

出証番号 出証特 2004-3037257